

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240716

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称 及人员姓名	融通基金：刘安坤、李文海、闵文强、何龙、王迪、张文玺、张彩婷、石础、张鹏、钱佳兴、陈甲铨；华福证券：沈颖洁、张帆等，共 13 名投资者及证券人员
时间	2024 年 7 月 16 日上午 10:00-12:00
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书兼副总经理杨平彩女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司 CMP 抛光垫业务放量节奏如何？</p> <p>答：今年公司 CMP 抛光垫业务展现出逐季度持续放量的良好态势，其中第一季度实现产品销售收入 1.35 亿元，同比增长 110.08%；5 月抛光硬垫产品单月销量破 2 万片，实现单月历史新高。预计第二季度实现销售收入约 1.64 亿元，环比增长 21.93%，同比增长 92.77%。公司将持续进行国内核心存储及逻辑晶圆厂客户的市场开拓，努力保持 CMP 抛光垫业务的同比增长态势。</p> <p>问 2：公司 CMP 抛光垫现有生产能力情况如何？</p> <p>答：公司目前已具备武汉年产 40 万片硬垫及潜江年产 20 万片软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件，产能储备充足，可为后续 CMP 抛光垫产品销售持续增长提供坚实的产能基础。此外，公司在 CMP 抛光垫产品上拥有多年稳定规模化生产的经验，生产管理理念、工艺、设备和检测方法不断改良，工厂良率、效率和材料利用率持续提升，产品品质稳定性达到更高水平。</p> <p>问 3：国内 CMP 抛光垫市场有进一步提升的空间吗？</p> <p>答：CMP 抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料，随着国内半导体产业规模的增长、下游晶圆厂客户的扩产，以及制程工艺节点的进</p>

	<p>步、芯片堆叠层数的增加，抛光步骤和 CMP 耗材用量将会增加，CMP 材料市场将进一步扩大。</p> <p>问 4：半导体显示材料业务今年放量情况如何？</p> <p>答：公司半导体显示材料 YPI、PSPI、TFE-INK 已在国内主流面板厂客户批量销售，其中 YPI、PSPI 产品已成为国内部分主流面板客户的第一供应商，确立相关产品国产供应领先地位。2024 年，公司半导体显示材料业务处于规模销售上量阶段，预计上半年实现产品销售收入约 1.68 亿元，同比增长 234.56%。其中第一季度实现销售收入 7,021 万元，第二季度预计实现销售收入约 9,825 万元，延续同比、环比双增长的趋势，保持了较好的业绩增长态势。随着显示行业复苏带来的下游面板客户稼动率提升，以及相关显示材料产品在客户端市场推广的持续进行，公司将努力保持半导体显示材料业务销售收入的增长态势。</p> <p>问 5：公司 CMP 抛光液、清洗液业务情况怎样？</p> <p>答：公司 CMP 抛光液、清洗液产品的销售上量及市场推广等工作持续进行中，2024 年上半年预计实现产品销售收入约 0.77 亿元，同比增长 190.87%。其中今年第二季度实现销售收入约 4,079 万元，环比增长 13.56%，同比增长 179.13%。此外，公司仙桃园区年产 1 万吨 CMP 抛光液（一期）及年产 1 万吨 CMP 抛光液用配套纳米研磨粒子产线经过公司高效的投料试产、工艺拉通，以及与客户紧密的验厂稽核、产线验证等工作，目前已具备大批量稳定规模量产能力，为 CMP 抛光液业务快速增量提供了坚实的基础。</p> <p>问 6：公司研磨粒子布局情况如何？</p> <p>答：研磨粒子是 CMP 抛光液的核心原材料，对抛光液产品品质有较大影响，同时在抛光液的材料成本中占比较高。公司实现了研磨粒子的自主制备，有助于增强公司抛光液产品供应链的安全、稳定、经济性，同时也能从研磨粒子入手对 CMP 抛光液产品进行定制化开发，使产品性能契合客户的使用需求，从而增强了公司 CMP 抛光液产品的核心竞争力。公司已在仙桃半导体材料产业园建成了与 CMP 抛光液产线配套的万吨级研磨粒子扩产项目，保障 CMP 抛光液产品上量过程中的研磨粒子需求。</p> <p>问 7：公司打印复印通用耗材业务经营情况如何？</p> <p>答：在打印复印通用耗材业务领域，公司完成了从上游耗材核心原材料到耗材终端成品的全产业链布局，上下游产业联动，支持公司在耗材产业领域的竞争优势。2024 年上半年度，公司打印复印通用耗材业务保持稳步发展，预计实现营业收入约 8.8 亿元，同比略有增长。公司持续进行管理优化、效率提升、降本控费等专项工作，全产业链综合竞争能力得到持续巩固。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 7 月 16 日